

ともに歩む、その先の革新へ



イビデン株式会社

2027 年 3 月期(2026 年度) 第 2 四半期決算説明会

2026 年 10 月 30 日(金)

イベント概要

[企業名] イビデン株式会社

[証券コード] 4062

[イベント言語] JPN

[イベント種類] 決算説明会

[イベント名] 2027 年 3 月期 第 2 四半期決算説明会

[開催日] 2026 年 10 月 30 日(金)

[開催時間] 10:00～11:00 (合計 1 時間：説明 20 分、質疑応答 40 分)

[開催場所] インターネット配信

[登壇者] 3 名

代表取締役社長

河島 浩二

経営役員 経営企画本部長

宮崎 信治

幹部職 経営企画部長

廣瀬 康人

2027 年 3 月期 第 2 四半期決算説明会 主な質疑応答

< 質問者 1 >

- [Q] 今回発表した河間事業場に対する約 1500 億円の追加投資について、立ち上げ時期や売上・利益率への貢献などについて教えてください。
- [A] 立ち上げ時期は 2029 年度後半を予定しており、業績には 2030 年度以降に寄与する見通しです。なお、お示ししている 2030 年度の売上高 1 兆円および営業利益 3000 億円の目標には、この追加投資分を含めていないため、上振れの可能性を含んでいます。利益率については、他製品と同様に 30%を超える水準を想定しています。
- [Q] 今回の能力増強投資は、なぜ EMIB-T ではなく EMIB になったのか、その背景や経緯を教えてください。EMIB-T の需要遅れや競合状況が影響しているのか、また EMIB-T の今後の需要見通しについても教えてください。
- [A] 当社はお客様からのご要求に基づき設備投資を行っています。EMIB および EMIB-T の需要はどちらも非常に強く、特に EMIB は現在お客様自身にとって非常に強みのある商品であるため、今回は EMIB 用の投資となりました。
- [Q] 中期経営計画における 2027 年度および 2030 年度の業績目標の前提について教えてください。
- [A] 2027 年度および 2030 年度の数字については、将来的な市場環境の変化リスクなどを考慮して少し厳しめの前提で見込んでいます。

< 質問者 2 >

- [Q] 競合他社が能力増強や新工場の取得を進める中で、競争環境に何か変化は起きていますでしょうか。また、来年度後半の EMIB-T 立ち上げのタイミングにおけるシェアやポジションについて、従来の見通しから変化があるのか、あるいは高いシェアを維持できると考えているのか教えてください。
- [A] AI 向け最先端分野においては、韓国メーカーが加わり 3 社体制になるという変化はありますが、各競合のキャパシティを合算しても全体の需要には届かないため、当社のポジションは変わりません。また CPU 向けに関しても、競合が他社の既存工場を購入するなど能力増強を進めていますが、同様にサプライヤー全体のキャパシティを合わせても需要に追いついていないため、構築したキャパシティはフル活用され、シェアやポジションに大きな変化はないと考えられます。
- [Q] マルチコア化や部品内蔵向け、ガラス等の高付加価値製品への切り替えが進む中で、償却負担などを考慮しても、利益率は 2030 年度に向けて上がっていくと考えて問題ないでしょうか？
- [A] 付加価値の高い製品へのシフトや製品ミックス、単価の見直しを含め、トータルの利益率は上がっていく方向と考えています。2030 年度には電子事業で 35%程度の営業利益率を見込んでおり、この上昇トレンドは少なくとも 2030 年度まで続くと考えています。

<質問者 3>

[Q] 河間事業場・大野事業場の新棟建設投資について、リードタイムはどのように考えていますか。

[A] 意思決定から最低でも4年はかかると考えます。

[Q] EMIB-Tについて、どこが技術的に一番難しいのか、来年度下期からの量産開始スケジュールに大きな変化はありますか。

[A] EMIB-Tで最も難しい部分はブリッジチップ下側の電気的コネクションを作る点であり、各社共通の課題と見ています。立ち上げ計画や量産スケジュールに特に大きな変化はなく、予定通り進める見通しです。

<質問者 4>

[Q] 中期経営計画の2030年度数字を変更していない理由について、具体的な懸念や要因は何でしょうか。

[A] 2030年度の計画を変更していない理由は、今回のセル6への追加投資に加えて、セル8の一部エリア、さらにその先の新工場検討などの未確定事項もあることによります。投資計画がまとまった段階で、今年度中に改めて中期の業績見通しの見直しを行い、皆さまにお知らせできると思います。

<質問者 5>

[Q] 2030年頃まで供給が追いつかない状況が長引くとのガイダンスがありましたが、顧客の視点から長期間の供給不足を受け入れるのは困難と考えられます。需給ギャップが埋まらなかった場合にどのような変化がどこで起こると見ており、その変化に対してどのように対応される考えでしょうか。

[A] 顧客からのデマンド情報等を合わせ込むと製品変化に伴う必要キャパの増加もあり、キャパは圧倒的に不足しています。こうした状況下では、通常、代替技術へのシフトがリスクとして挙げられますが、現在の最先端ICパッケージ基板を代替できる技術はないと考えています。結果的にデマンド側で抑えるしかならないと考えています。

以上